

盐晶切割芯片晶圆片激光精密划线半导体硅片钻孔微孔小孔来图加工

产品名称	盐晶切割芯片晶圆片激光精密划线半导体硅片钻孔微孔小孔来图加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	华诺激光:微纳切割打孔定制 加工设备:皮秒, 纳秒 加工地:北京
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

盐晶切割芯片晶圆片激光精密划线半导体硅片钻孔微孔小孔来图加工

诺激光公司是一家以激光切割、激光打孔、激光焊接、激光打标刻字的为主的。承接0.13mm-20mm各种激光切割、开孔钻孔、划线、开槽、刻图形字体，各种透光材质都可做。

激光可以进行曲线图形的切割。激光切割有机玻璃有速度快、精度高，定位准确等明显优势。并可在工艺礼品、面板镜片机箱、等行业广泛的应用。

晶圆便是硅元素加以纯化（99.999%），接着是将这些纯硅制成长硅晶棒，成为制造积体电路的石英半导体的材料，经过照相制版，研磨，抛光，切片等程序，将多晶硅融解拉出单晶硅晶棒，然后切割成一片一片薄薄的晶圆。

硅片规格有多种分类方法，可以按照硅片直径：4寸、6寸、12寸、3英寸、2英寸；单晶生长方法：单晶硅片、多晶硅片；掺杂类型：N型、P型等参量和用途来划分种类。